

平成 19 年 10 月 31 日

報 道 各 位

新日鉱グループ

○日鉱金属株式会社

450mm多結晶シリコン・ハンドリングテストウェハーの開発について

日鉱金属株式会社（本店：東京都港区虎ノ門二丁目 社長：岡田昌徳 以下「当社」）は、当社磯原工場において、今般、世界で初めて450mmハンドリングテストウェハー（以下「本製品」）の開発に成功し、来年以降本格的に販売を開始することといたしました。

半導体用基板材料であるシリコンウェハーは、現在、直径200mmから300mmの製品が用いられていますが、半導体メーカーにおいては、更なるコスト低減・生産効率の向上を図るため、将来的には直径450mmのシリコンウェハーの導入を計画しております。今般当社が開発に成功した本製品は実際の半導体製造に用いられるものではなく、半導体関連製造設備メーカー等において450mmシリコンウェハー用の各種プロセス開発のために使用されるものであります。

当社では、本製品の提供によって、次世代電子デバイスの製造技術革新に寄与するとともに、450mmウェハー・プロセス用の薄膜材料の開発に積極的に取り組むことにより、半導体材料におけるファーストベンダーの地位を堅持してまいります。

以 上

【お問合せ先】

日鉱金属株式会社

総務部総務担当 河田， 檜崎

TEL：03-5573-7223

ご参考



200mm

450mm